

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2024-046

希荻微电子集团股份有限公司

关于参加 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会

暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 投资者可于 5 月 10 日（星期五）16:00 前通过公司邮箱 ir@halomicro.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2023 年度芯片设计专场集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年5月13日下午15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心（网址 <https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：TAO HAI（陶海）

董事会秘书、财务负责人、副总经理：唐娅

独立董事：王一鸣

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年5月13日下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于5月10日（星期五）16:00前通过公司邮箱 ir@halomicro.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐娅

电话：0757-81280550

邮箱：ir@halomicro.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024年4月30日